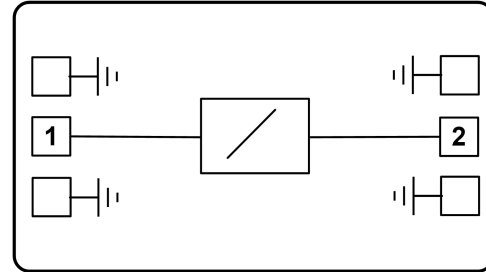




### 主要特点

- 频率范围: 6 - 18 GHz
- 插入损耗: 0.6 dB @ 18 GHz
- 均衡量: 4 dB
- 输入输出回波损耗: 20 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 0.85 × 1.0 × 0.1 mm<sup>3</sup>

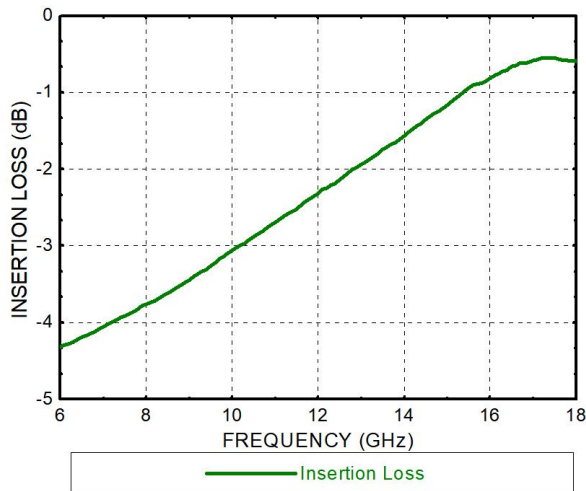
### 功能框图



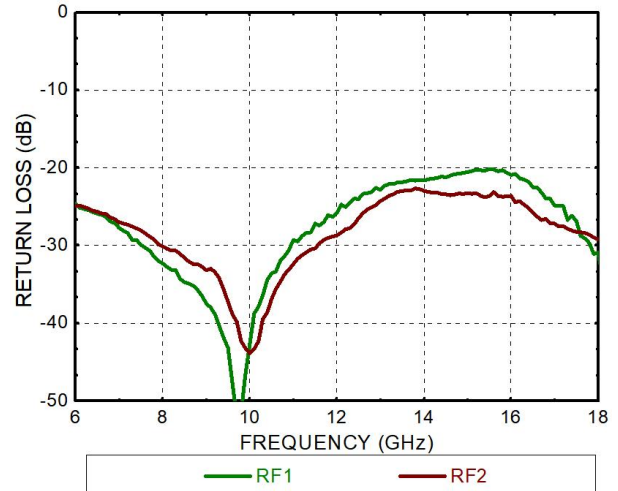
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	6 - 18			GHz
插入损耗@18GHz		0.6		dB
均衡量		4		dB
回波损耗		20		dB

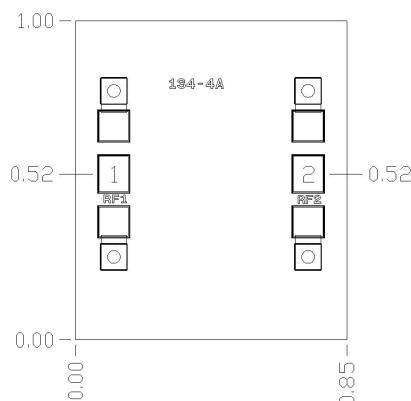
### 插入损耗



### 回波损耗



### 物理参数



### 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频输入/输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm, 如果外部射频电压不是 0V, 那么需要外接隔直电容



## 注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为  $120*100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：  
0.5+1.6 $\mu\text{m}$

## 极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$